

3年ぶりの修善寺開催に併せて2つの特別展示を企画！！

一般社団法人 エレクトロニクス実装学会 主催



第32回 2023 JIEP修善寺ワークショップ^o 開催案内

2023年10月12日(木)~13日(金)
ラフォーレ修善寺 サンパティックホール

一般参加者大募集！

日本半導体の産業復権を支える実装技術
～鍵を握る材料・装置・プロセス技術～

Face-to-face
本音トーク
若手からベテランまで
ノースーツ/ノースクタイ



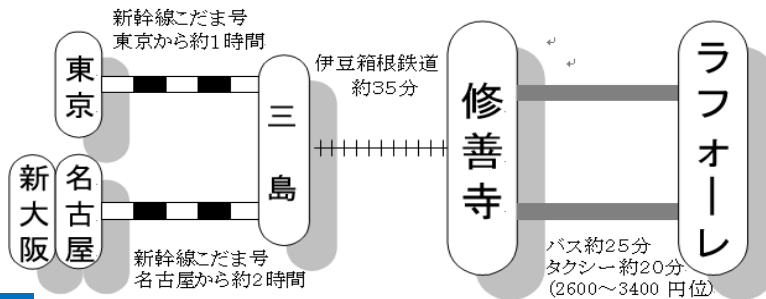
職場を離れ、自然の中で、心行くまでディスカッションしよう！

- 招待講演
『半導体実装装置メーカーからみた日本の半導体産業への期待と実装技術(仮)』
寺田 勝美 様 (東レエンジニアリング株式会社)
- ナイトセッション『**電動車搭載デバイスの実装技術と関連特許について**』
& 特別展示『EV用駆動モジュール“eアスクル”などの分解展示』
箸尾 勝 様 (株式会社エルテック)
- 特別展示
日本初の民間ロケット開発企業 インターステラテクノロジズ社による
『ロケットエンジン、アビオニクスの実物展示と技術紹介』
- ポスター発表 (45件)
配線、3D/光、実装材料、プロセス・装置、接合技術、パワエレ、センシング分野から厳選



2023ワークショップ実行委員会 委員長 子林 みどり (CYBERDYNE)

アクセス



スケジュール(予定)

修善寺駅からは送迎バスを ご利用ください。

10月12日(木)		10月13日(金)	
13:00~	登録開始	07:30~08:30	朝食
13:30~13:50	オリエンテーション	09:15~	2日目セッション開始
13:50~15:00	第1セッション (アブストラクトトーク)	09:30~10:30	第3セッション (アブストラクトトーク)
15:00~17:00	第1セッション (ポスター)	10:30~11:30	第3セッション (ポスター前半)
18:00~19:30	夕食 (立食形式懇親会)	11:30~12:30	昼食
20:00~21:00	ナイトセッション講演	12:30~13:30	第3セッション (ポスター後半)
21:00~	第2セッション (自由討論)	13:40~14:40	招待講演
	就寝	14:45~	アンケート・閉会式・現地解散

プログラム

■ **ナイトセッション・特別展示 『電動車搭載デバイスの実装技術と関連特許について』**

菅尾 勝/エルテック

(敬省略)

■ **特別展示 日本初の民間ロケット開発企業インターステラテクノロジズ社より**

『ロケットエンジン、アピオニクスの実物展示と技術紹介』

■ **招待講演 『半導体実装装置メーカーからみた、日本の半導体産業への期待と実装技術(仮)』**

寺田 勝美/東レエンジニアリング

■ **ポスターセッション**

10/12(木) 15:00 - 17:00 (第1セッション)		10/13(金) 10:30-11:30/12:30-13:30(第3セッション)	
配線/垂直加工	1. ウェットプロセスによる超高アスペクト比加工への挑戦と その応用 川上宙輝/東芝	配線/垂直加工	22. (仮題)インプリントによる高アスペクト配線/パンプ形成 小松 裕司/コネクテックジャパン
	2. より深くより真っ直ぐに。2周波ICP-TSV技術 鈴木 大地/アルバック		23. レジストレスでの配線形成を可能とする選択的表面改質法 によるダイレクトパターンニング技術(仮) 堀内義夫/関東学院大学
	3. 光ナノインプリントを用いた光電コパッケージ実装技術の開発 中村文/産総研		24. 次世代3D-MIDに向けた分子接合剤によるめっき配線形成 目黒 和幸/岩手県工業技術センター
3D・光	4. 3Dチップレット集積のためのポリマーファインピエッチングプロセス 技術の開発 大竹 文人/アルバック	接合技術	25. 低荷重接合を実現する先鋭マイクロパンプ接合技術の開発 五十井浩平/パナソニックホールディングス
	5. ウエハレベル三次元集積化用接着剤の開発 新木直子/ダイセル		26. 液体金属Gaを用いた低温接合 山中公博/中京大学
	6. Cavity構造をもつ有機サブストレート基板の反り抑制設計手法 森 裕幸/日本IBM		27. 開発効率向上のための半導体接合材における界面電気抵抗 測定手法の確立(仮). 小池 大輔/東芝デバイス&ストレージ
材料技術	7. 各種機能性表面処理剤の開発(耐熱、絶縁、撥液など) 佐古 弘志/日本パーカライジング	3D・光	28. (仮) 異種集積向け高速チップレット接着技術の研究 工藤 拓也/東京工業大学/ 村田製作所
	8. CFDを用いたアンダーフィルの流体挙動解析 宮澤 理沙/日本IBM		29. Cu-Cuハイブリッド接合用新規接着材料による積層プロセス 検証 田村佳保里/三井化学
	9. 微細配線形成可能な新規低誘電PPEフィルム 中 佑介/太陽インキ製造		30. 紫外線除菌技術Care222の展開について 平尾哲治/ウシオ電機
	10. 再配線層における低誘電ポリミドの開発(仮題) 小笠原 央/東レ		31. 次世代向けガラス基板への無電解銅めっきプロセスの開発 佃 真優/奥野製薬工業
パワエレ	11. 自動車電動化に向けた 高耐熱脂環式エポキシ樹脂の開発 福住謙亨/ダイセル	材料技術	32. 低誘電特性と加工性を両立する新規・熱硬化性樹脂の開発 渡邊 隆明/三菱ケミカル
	12. パワー半導体チップ下はんばボイドの熱シミュレーション 荻谷 平/東芝デバイス&ストレージ		33. 「のびーる」アクリルエラストマー基材の開発と導電材料への応用 宮澤 悠/大阪有機化学工業
接合技術	13. マイクロスケール力学評価/三次元構造解析の融合による 接合界面局所破壊挙動の解明 松田 朋己/大阪大学		34. 銅系導電性ペーストの電気的特性および信頼性向上のための 界面化学制御 松浪 由香里/群馬大学
	14. チタン超音波接合の進展メカニズムの検討 篠原勇人/東芝		35. CNT系導電性ペーストの界面電気伝導促進のためのバインダ 配合設計 井上 雅博/群馬大学
	15. ニッケルナノ粒子-アルミニウムマイクロ粒子接合材を用いた 大気加熱による高耐熱接合 小柴佳子/神奈川県立産総研	36. マイクロLEDディスプレイ製造における歩留まり改善に 向けた取り組み 梅田英知/東レエンジニアリング	
信頼性	16. 絶縁放熱基板(DBA, DBC)及び実装材料の信頼性評価 西元 修司/三菱マテリアル	装置・製造	37. 次世代パワー半導体への最新モルディング技術 斉藤 高志/アピックヤマダ
装置・製造	17. フルアディティブ工法を応用したエレクトロニクス3Dプリンター の開発 瀧川 慎二/FUJI		38. ニセモノ部品排除へ! 新規真贋判定プロセスの提案 高野 健/リンテック
	センシング	18. 『Advancedpackageprocess』に対応したステップ&リピート 投影露光装置の現状と課題 ウシオ電機/高橋 遼太郎	センシング
19. ドライバーの安全をさりげなく見守る印刷製造シートベルト型 センサ 野村 健一/産総研		40. “見える”が拓く半導体DX設計・予測・標準の革新 寺崎 正/産総研	
20. ウェアラブルな小型深部体温計測モジュールの開発 福井翔也/諏訪東京理科大学大学院		41. (筋肉の声に) 耳をすませば 竹井裕介/産総研	
特別展示	* 展示は両日実施 日本初の民間ロケット開発に取り組むインターステラテクノロジズ社より 「ロケットエンジン、アピオニクスの実物展示と技術紹介」 10分プレゼン	パワエレ	42. パワーモジュール用封止材料の湿度拡散に関する検討 登 羽香奈/三菱電機
			43. SiCやGaNなどパワー半導体の性能を究極に生かす3D実装 の可能性 中村 和人/名古屋大学
			44. ポリプロピレンの耐熱寿命予測 喜田 樹里/東芝
信頼性	信頼性	45. パワーモジュール用ワイヤ接合部の「機械的疲労試験」 による寿命評価 上野優真/鹿児島大学院	

申込： 下記よりお申し込みください。

[一般参加はこちらから](#)

[発表者はこちらから](#)

参加費用： 正会員・賛助会員： ¥ 45,000、シニア会員： ¥ 40,000、学生会員： ¥ 35,000、
一般： ¥ 55,000 JPCA会員： ¥ 45,000
(資料代、宿泊費、食事、消費税を含みます。*なお一般の方は、同時に学会にご入会いただくと、
初年度のみ年会費半額で、かつ今回のワークショップに会員扱いでご参加いただけます。)
*宿泊はゆったり70m²のセンターハウス1部屋に4名以下で。
同年代・興味分野の近い方同士で、じっくり議論 & 交流いただけます。

申込締切： 9月25日(月) (ただし、定員になり次第、締め切らせていただきます。)

定員： 100名(先着申込順), 支払方法： 銀行振込。申込後のキャンセル不可。

問合せ先： 〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2, Tel:03-5310-2010,
Email: 2023ws@jiep.or.jp